

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-094

证券代码:113669 证券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于珠海金湾基地扩产投资计划的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 投资标的名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。
● ● 投资金额:项目预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据项目实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。
● 资金来源:自有资金或自筹资金。
● 相关风险提示:项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响,可能在达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业动态,与客户保持密切沟通,以市场为导向,深入洞察技术发展趋势,科学把握资源节约、成本控制能力,以减少前述风险带来的影响。本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)为迎接AI浪潮下全球科技产业链重构机遇,加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足全球客户的长期、高标准需求,提升公司在高端产品的竞争优势,拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资。扩产投资项目主要用于现有工厂的技术改造升级及产能提升,新工厂的建设,提升高阶HDI、HLC、SLP的产能和技术能力,满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域客户的需求。

(二) 董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次对外投资事项。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况
(一) 项目名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。

(二) 项目建设地点:景旺电子珠海金湾基地园区(详细地址:珠海市金湾区南水镇南水大道901号)。

(三) 项目实施主体:景旺电子(珠海)有限公司。

(四) 项目投资规模:本次扩产投资计划预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。

(五) 项目建设内容:
结合市场需求情况和公司战略布局,本次投资拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,主要包括在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能,在HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线,投资新建高阶HDI工厂,利用储备用地增加投资强化关键工序产能。扩

产项目定位于AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高阶HDI、HLC、SLP产品,通过此次扩产投资,整合珠海金湾基地资源,增强公司高端产品制造能力,强化高端产品供应交付能力。公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施该项目。

(六) 项目建设周期:本次投资建设周期为2025年至2027年。

(七) 资金来源:自有资金或自筹资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次扩产项目投资有利于公司牢牢把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇,有助于提升公司在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足客户的中长期、高标准需求,有助于构建技术壁垒,增强核心竞争力与市场地位,进一步扩大公司经营效益。从长期来看,公司对未来发展和经营收益具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资项目尚需公司有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通,推动项目实施有关的审批工作。

2. 本次投资项目是公司基于战略发展需要及对行业市场前景的判断,但宏观经济、行业政策、市场和技术变化,内部经营管理等因素存在一定的不确定性,可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注行业动态,与客户保持密切沟通,以市场为导向,深入洞察技术发展趋势,科学把握投资节奏,积极强化运营管理,和成本控制能力,以减少前述风险带来的影响。本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

3. 本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

4. 一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)为迎接AI浪潮下全球科技产业链重构机遇,加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足全球客户的长期、高标准需求,提升公司在高端产品的竞争优势,拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资。扩产投资项目主要用于现有工厂的技术改造升级及产能提升,新工厂的建设,提升高阶HDI、HLC、SLP的产能和技术能力,满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域客户的需求。

(二) 董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次对外投资事项。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况
(一) 项目名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。

(二) 项目建设地点:景旺电子珠海金湾基地园区(详细地址:珠海市金湾区南水镇南水大道901号)。

(三) 项目实施主体:景旺电子(珠海)有限公司。

(四) 项目投资规模:本次扩产投资计划预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。

(五) 项目建设内容:
结合市场需求情况和公司战略布局,本次投资拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,主要包括在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能,在HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线,投资新建高阶HDI工厂,利用储备用地增加投资强化关键工序产能。扩

产项目定位于AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高阶HDI、HLC、SLP产品,通过此次扩产投资,整合珠海金湾基地资源,增强公司高端产品制造能力,强化高端产品供应交付能力。公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施该项目。

(六) 项目建设周期:本次投资建设周期为2025年至2027年。

(七) 资金来源:自有资金或自筹资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次扩产项目投资有利于公司牢牢把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇,有助于提升公司在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足客户的中长期、高标准需求,有助于构建技术壁垒,增强核心竞争力与市场地位,进一步扩大公司经营效益。从长期来看,公司对未来发展和经营收益具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资项目尚需公司有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通,推动项目实施有关的审批工作。

2. 本次投资项目是公司基于战略发展需要及对行业市场前景的判断,但宏观经济、行业政策、市场和技术变化,内部经营管理等因素存在一定的不确定性,可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注行业动态,与客户保持密切沟通,以市场为导向,深入洞察技术发展趋势,科学把握投资节奏,积极强化运营管理,和成本控制能力,以减少前述风险带来的影响。本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

3. 本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

4. 一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)为迎接AI浪潮下全球科技产业链重构机遇,加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足全球客户的长期、高标准需求,提升公司在高端产品的竞争优势,拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资。扩产投资项目主要用于现有工厂的技术改造升级及产能提升,新工厂的建设,提升高阶HDI、HLC、SLP的产能和技术能力,满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域客户的需求。

(二) 董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次对外投资事项。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况
(一) 项目名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。

(二) 项目建设地点:景旺电子珠海金湾基地园区(详细地址:珠海市金湾区南水镇南水大道901号)。

(三) 项目实施主体:景旺电子(珠海)有限公司。

(四) 项目投资规模:本次扩产投资计划预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。

(五) 项目建设内容:
结合市场需求情况和公司战略布局,本次投资拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,主要包括在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能,在HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线,投资新建高阶HDI工厂,利用储备用地增加投资强化关键工序产能。扩

产项目定位于AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高阶HDI、HLC、SLP产品,通过此次扩产投资,整合珠海金湾基地资源,增强公司高端产品制造能力,强化高端产品供应交付能力。公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施该项目。

(六) 项目建设周期:本次投资建设周期为2025年至2027年。

(七) 资金来源:自有资金或自筹资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次扩产项目投资有利于公司牢牢把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇,有助于提升公司在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足客户的中长期、高标准需求,有助于构建技术壁垒,增强核心竞争力与市场地位,进一步扩大公司经营效益。从长期来看,公司对未来发展和经营收益具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资项目尚需公司有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通,推动项目实施有关的审批工作。

2. 本次投资项目是公司基于战略发展需要及对行业市场前景的判断,但宏观经济、行业政策、市场和技术变化,内部经营管理等因素存在一定的不确定性,可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注行业动态,与客户保持密切沟通,以市场为导向,深入洞察技术发展趋势,科学把握投资节奏,积极强化运营管理,和成本控制能力,以减少前述风险带来的影响。本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

3. 本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

4. 一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)为迎接AI浪潮下全球科技产业链重构机遇,加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足全球客户的长期、高标准需求,提升公司在高端产品的竞争优势,拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资。扩产投资项目主要用于现有工厂的技术改造升级及产能提升,新工厂的建设,提升高阶HDI、HLC、SLP的产能和技术能力,满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域客户的需求。

(二) 董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次对外投资事项。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况
(一) 项目名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。

(二) 项目建设地点:景旺电子珠海金湾基地园区(详细地址:珠海市金湾区南水镇南水大道901号)。

(三) 项目实施主体:景旺电子(珠海)有限公司。

(四) 项目投资规模:本次扩产投资计划预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。

(五) 项目建设内容:
结合市场需求情况和公司战略布局,本次投资拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,主要包括在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能,在HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线,投资新建高阶HDI工厂,利用储备用地增加投资强化关键工序产能。扩

产项目定位于AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高阶HDI、HLC、SLP产品,通过此次扩产投资,整合珠海金湾基地资源,增强公司高端产品制造能力,强化高端产品供应交付能力。公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施该项目。

(六) 项目建设周期:本次投资建设周期为2025年至2027年。

(七) 资金来源:自有资金或自筹资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次扩产项目投资有利于公司牢牢把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇,有助于提升公司在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足客户的中长期、高标准需求,有助于构建技术壁垒,增强核心竞争力与市场地位,进一步扩大公司经营效益。从长期来看,公司对未来发展和经营收益具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资项目尚需公司有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通,推动项目实施有关的审批工作。

2. 本次投资项目是公司基于战略发展需要及对行业市场前景的判断,但宏观经济、行业政策、市场和技术变化,内部经营管理等因素存在一定的不确定性,可能存在收益不达预期的风险。公司将密切关注行业动态,与客户保持密切沟通,以市场为导向,深入洞察技术发展趋势,科学把握投资节奏,积极强化运营管理,和成本控制能力,以减少前述风险带来的影响。本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

3. 本次投资项目的目标金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

4. 一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)为迎接AI浪潮下全球科技产业链重构机遇,加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足全球客户的长期、高标准需求,提升公司在高端产品的竞争优势,拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资。扩产投资项目主要用于现有工厂的技术改造升级及产能提升,新工厂的建设,提升高阶HDI、HLC、SLP的产能和技术能力,满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域客户的需求。

(二) 董事会审议情况
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次对外投资事项。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况
(一) 项目名称:景旺电子珠海金湾基地扩产项目。

(二) 项目建设地点:景旺电子珠海金湾基地园区(详细地址:珠海市金湾区南水镇南水大道901号)。

(三) 项目实施主体:景旺电子(珠海)有限公司。

(四) 项目投资规模:本次扩产投资计划预计总投资人民币50.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目实际建设投资开支为准。

(五) 项目建设内容:
结合市场需求情况和公司战略布局,本次投资拟使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资,主要包括在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能,在HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线,投资新建高阶HDI工厂,利用储备用地增加投资强化关键工序产能。扩

产项目定位于AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高阶HDI、HLC、SLP产品,通过此次扩产投资,整合珠海金湾基地资源,增强公司高端产品制造能力,强化高端产品供应交付能力。公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施该项目。

(六) 项目建设周期:本次投资建设周期为2025年至2027年。

(七) 资金来源:自有资金或自筹资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次扩产项目投资有利于公司牢牢把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇,有助于提升公司在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高端产品布局,满足客户的中长期、高标准需求,有助于构建技术壁垒,增强核心竞争力与市场地位,进一步扩大公司经营效益。从长期来看,公司对未来发展和经营收益具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资项目尚需公司有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延